

Product Overview

SK-AM62B-P1 设计包内容概述



表 1 列出了 SK-AM62B-P1 中包含的文件夹名称、文件夹中的文件名称以及所有文件的格式。SK-AM62B-P1 入门套件评估模块 (SKEVM) 是一种基于 AM623/AM625 SoC 构建的低成本 SKEVM (13mm x 13mm、0.5mm 间距、425 引脚 FCCSP BGA [ALW])。该处理器包含一个四核 64 位 Arm® Cortex® A53 微处理器、一个单核 Arm Cortex-R5F MCU 和一个 Arm Cortex-M4F MCU。产品概述文档位于 TI.com 上的 SK-AM62B-P1 产品文件夹中，供客户在下载单个 Zip 文件夹之前查看。

表 1. Proc142A

文件夹 (第 1 级)	文件夹 (第 2 级)	所含文件	文件类型
----	----	Proc142A_Folders_Files_List	XLS
1_SCHEMATIC	PDF	PROC142A(002)_SCH_With_Design_Updates..Notes_V1.0	PDF
	PDF -Backup_SK_Schematic	PROC142A(002)_sch	PDF
	----	Schematic_Revision_Readme	PDF
	ORCAD	PROC142A(002)_Sch_With_Design_Updates..Notes_V1.0	DSN
	ORCAD - Backup_SK_Schematic	PROC142A_SCH	DSN
2_BOM	----	PROC142A(002)_BOM_With_Design_Updates..Notes_V1.0	XLS
	Backup_SK_Schematic_BOM	PROC142A(002)_BOM	XLS
3_Board_File	Allegro	PROC142A_BRD	BRD
	Simulation Scorecard	AM62x_Simulation_Scorecard	PDF
	Altium_ASCII	PROC142A_BRD	ALG
4_Gerber	ODBGBR	PROC142A_ODBGBR	ZIP
	274X	PROC142A_274xGBR	ZIP
	IPC-D-356_NETLIST	PROC142A_BRD	IPC
5_Gerber_PDF	FAB	PROC142A_FAB	PDF
	PCB LAYERS	PROC142A-LAYERS	PDF
	Geber Layers	PROC142A-LAYERS	PDF
6_Assembly_Models_Package	2D	PROC142A_BASY	DXF
		PROC142A_TASY	DXF
	3D	PROC142A_3D_STEP	STP
		IDF	PROC142A_BRD
	PROC142A_BRD		EMN
	Assembly_Drawing_PDF	PROC142A_ASSEMBLY	PDF
		PROC142A_TASY	PDF
		PROC142A_BASY	PDF
	STNL	art_aper + 8 x .ART 文件	ART
	XY-REP	PROC142A_XY-REP	XLS
7_PCB_LAYER_STACKUP	---	SK-AM62B-P1_Proc142A_Layer_STACKUP	PDF
8_Power_Supply_Sequencing	---	SK-AM62B-P1_Proc142A_Power Sequence	PDF

参考资料

- 德州仪器 (TI), [\[常见问题解答\] AM625/AM623 定制电路板硬件设计 - 用于重复使用 SK-AM62B-P1 原理图的设计和审查说明](#)

商标

Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited.

所有商标均为其各自所有者的财产。

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司